

中国汽车工程学会文件

中汽学科[2026]134号

关于举办 2026 北京车展科技创新论坛的通知

各有关单位、专家：

2026 年，智能汽车迈入 AI 驱动、舱驾融合、规模化量产的关键节点。人机交互从屏端中心向空间交互、全域协同演进，高阶智驾加速从试点示范走向规模应用，产业竞争焦点转向技术落地实效、成本控制能力与生态融合深度。

然而，行业仍面临交互体验碎片化、软硬件协同不足、生态服务割裂、芯片—传感器—算法体系协同度不高等共性挑战。以全息风挡、光场显示为代表的前沿光显技术，以及车规级芯片、高性能感知系统、智驾大模型等关键底座，正成为重构座舱体验、驱动智驾规模化落地的核心力量。

为应对挑战，把握机遇，中国汽车工程学会作为 2026（第十九届）北京国际汽车展览会承办单位，将于 4 月 26 日在北京举办 2026 北京车展科技创新论坛。论坛将汇聚整车、光学、芯片、传感器、算法及供应链权威力量，共探舱驾融合技术路径，突破产业协同瓶颈，以技术创新与生态合力，推动我国智能汽车产业高质量发展。

一、 时间地点

会议时间：2026 年 4 月 26 日

会议地点：首都国际会展中心大酒店宴会厅

二、 总体日程

时间		论坛主题
4月26日	上午	光显未来·智舱共生：智能座舱空间交互与生态融合
	下午	芯-感-智协同创新赋能高阶智驾规模化落地
	全天	蔡司全息风挡显示样机现场体验活动(报名页扫码预约)

三、 参会报名

本次会议不收取会议费，参会人员差旅自理。

请于4月23日前通过官方网站或扫描下方二维码进行参会报名。

报名网址：<https://meeting.sae-china.org/AutoChinaForum2026/>

报名二维码：



附件1：光显未来·智舱共生：智能座舱空间交互与生态融合初步日程

附件2：芯-感-智协同创新赋能高阶智驾规模化落地初步日程



附件 1:

光显未来·智舱共生：智能座舱空间交互与生态融合 初步日程

时间	演讲主题/拟邀嘉宾
	主持人： 郭 钢 重庆大学机械与运载工程学院教授，中国汽车工程学会汽车智能座舱分会主任委员
9:30-9:35	领导致辞
9:35-9:55	智能座舱空间交互新趋势与产业生态构建 郭 钢 重庆大学机械与运载工程学院教授，中国汽车工程学会汽车智能座舱分会主任委员
9:55-10:15	小米 HyperVision 天际屏显示技术 黄晓玥，小米汽车显示技术负责人
10:15-10:35	从实验室走向量产：全息风挡显示产业化，赋能新一代智能座舱 Stephan Hoefler 蔡司微光学汽车及消费市场业务拓展、大客户及市场营销高级副总裁
10:35-10:55	全息空间交互上车：高端座舱体验定义与量产落地 万 宏 长安科技/梧桐科技座舱显示高级总监、首席座舱显示专家
10:55-11:15	当导航遇见自动驾驶——在全球范围内规模化构建值得信赖的 NOA Severin Bredahl-Banovic VP, Business & Solution Architecture HERE Technologies
11:15-11:35	多模态感知驱动方案，赋能空间交互与生态融合 杨 矾 纳芯微接口业务负责人
11:35-12:05	圆桌论坛：打破边界，协同破局——空间交互量产落地的产业链对话 初拟子议题： 1. 下一代光显技术（全息风挡/光场显示）如何重构座舱空间交互体验 2. 光显座舱产业化的关键瓶颈与破局路径 3. 舱驾融合背景下，座舱生态如何实现跨域协同与体验统一 4. 供应链与整车协同：如何加速空间交互方案规模化上车 参与嘉宾： 曹 斌 长安科技软件架构总经理兼任梧桐车联 CEO Stephan Hoefler 蔡司微光学汽车及消费市场业务拓展、大客户及市场营销高级副总裁 黄晓玥 小米汽车显示技术负责人 知名 OEM 智能座舱相关专家

附件 2:

芯-感-智协同创新赋能高阶智驾规模化落地

初步日程

时间	演讲主题/拟邀嘉宾
13:30-13:40	主持人开场 徐月云 中国汽车工程学会传感器分会秘书长、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司智能事业部总经理
13:40-14:00	L3 准入落地背后的系统工程：高阶自动驾驶规模化的产业实践 崔茂源 中国第一汽车股份有限公司研发总院首席
14:00-14:20	智驾 AI 大模型技术创新与量产实践 北汽/蔚来/吉利千里科技
14:20-14:40	高性能中央计算芯片赋能整车架构创新与智能演进 张效宇 中兴微汽车电子副总经理、营销 MKT 总经理
14:40-15:00	舱驾融合趋势下的整车计算平台重构 黑芝麻/芯驰
15:00-15:20	云芯一体“智能位置数字底座”赋能智能网联汽车 张冰 北斗星通云芯事业群副总经理、和芯星通总经理
15:20-15:30	《中国电动汽车工业年鉴》发布仪式 机械工业出版社
15:30-15:40	茶歇
15:40-16:00	全球汽车半导体产业发展机遇与挑战 产业研究机构
16:00-16:20	高安全车规 MCU 赋能动力底盘智能演进 芯旺微/紫光/国芯
16:20-16:40	高性能车规存储解决方案与国产化进阶 史有强 兆易创新科技股份有限公司市场总监
16:40-17:00	高性能雷达技术创新与量产实践 楚航科技/速腾聚创/禾赛
17:00-17:20	下一代车载雷达技术演进与车云一体全天候智驾赋能 宸芯科技/高德红外/四维图新